

# 东芯半导体股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任，进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力，维护全体股东的利益，公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 8 月 23 日制定并发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2025 年度（以下简称“报告期”），公司积极开展和落实行动方案各项工作，取得了良好的效果，现将行动方案 2025 年度执行情况评估如下，并制定了 2026 年度的优化目标和提升举措：

### 一、聚焦公司主业，优化业务布局

2025 年，公司所处的中小容量存储芯片市场受益于人工智能驱动的新一轮行业上升周期，供需结构持续优化，产品销售价格稳步回升。公司坚定深耕存储芯片主业，把握 5G、智慧安防、智能穿戴及汽车智能化等下游需求复苏与结构性增长机遇，通过有效的市场策略与客户拓展，带动营业收入与盈利能力同步提升。报告期内，公司实现营业收入 9.21 亿元，同比增加 43.76%；整体毛利率较上年同期相比大幅提升，各季度毛利率均实现环比增长，报告期内存储板块业务已实现盈利。同时，公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多多样化的芯片解决方案。

#### （一）深耕主营业务，坚持技术创新

报告期，公司聚焦主营存储产品，持续实施产品更新迭代策略。

##### 1、存储产品线持续升级迭代

公司继续巩固在 SLC NAND Flash 领域的技术领先优势。报告期内，“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售。公司稳步推进 2xnm 制程 SLC NAND Flash 系列产品研发，进一步提升了可靠性指标，并持续扩充产品料号。

在 NOR Flash 领域，公司基于 48nm 及 55nm 制程，持续推进 64Mb~2Gb 中高容量产品的研发，实现了性能、功耗与性价比的合理平衡。随着产品线持续迭代

与丰富，公司为可穿戴设备、安防监控、物联网及汽车电子等领域客户提供更多样化、更高可靠性的产品选择。

在 DRAM 领域，公司已实现 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、LPDDR4X、PSRAM 等产品的量产，并持续完善新产品研发布局。公司产品凭借小尺寸封装、低电压设计及宽温适应性，覆盖消费电子、工业及汽车电子等多元化应用场景，在移动设备轻薄化、工业场景高可靠性及 AIoT 数据处理需求中展现出技术优势。

公司目前可提供 4Gb+4Gb、8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 等多种容量组合的 MCP 产品，广泛应用于 5G 通讯模块、车载模块等领域。公司持续研发更多容量组合方案，通过自研 SLC NAND Flash 与 DRAM 的高效集成，打造兼具成本优势与性能稳定性的 MCP 产品。

## 2、车规级存储产品矩阵加速构建

公司持续提升车规级存储产品可靠性水平，稳步推进研发及产业化进程。报告期内，公司 SLC NAND Flash、NOR Flash 及 MCP 三大品类的车规产品阵容持续扩充，更多型号顺利通过 AEC-Q100 验证；同时，公司已将车规标准前置融入整体研发体系。公司成功通过了 IATF 16949:2016 质量管理体系第三方符合性认证，完善了汽车行业研发及供应链质量管理流程。在客户导入方面，公司已成功完成国内多家整车厂的白名单导入，并通过海内外 Tier 1 供应商在多款车型中实现规模量产；产品应用于通信及远程控制系统、激光雷达、机器视觉、电池 DMS 系统及智慧座舱等汽车电子核心系统。

## （二）深化“存、算、联”一体化战略，优化业务布局

报告期内，公司持续推进“存、算、联”一体化战略布局，通过技术创新、生态协同与产业链延伸，逐步构建起以存储芯片为核心，覆盖计算、通信领域的多元化技术生态体系，旨在建立一体化的生态发展体系，为未来增长注入新动能。

### 1、“联接”芯片：Wi-Fi 7 研发取得阶段性成果

公司持续推进 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计，精准切入技术壁垒较高的路由、高端黑电透传及车载类 Wi-Fi 等细分赛道。公司首款无线传输芯片定位于高带宽、低延迟应用场景。报告期内，公司已完成原型机样片测试，其核心性能符合设计目标。通过差异化技术创新，公司致力于为客户提供本土化的智能无线通信与感知芯片及系统级解决方案。

## 2、“计算”芯片：GPU 战略布局深化

公司通过战略投资切入高性能 GPU 赛道。公司于 2024 年通过自有资金 2 亿元战略投资砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”），并于报告期内追加投资约 2.11 亿元，持续深化布局。上海砺算专注于多层次（可扩展）图形渲染 GPU 芯片的研发设计，坚持核心 IP 自研，在 GPU 架构设计等关键技术环节拥有完整的自主知识产权。报告期内，上海砺算首款自研 GPU 芯片“7G100”首次流片成功，少量显卡已交付客户。产品量产及销售拓展等工作正按计划有序开展。

### （三）保持高水平研发投入，坚持核心技术自主可控

公司高度重视知识产权的自主性与完整性，在不断开发新技术、新产品的同时，通过多种途径对相关的知识产权进行保护。报告期内，公司新增申请发明专利 4 项，获得发明专利授权 23 项；申请实用新型专利 1 项；申请集成电路布图设计权 5 项，获得集成电路布图设计权 5 项；申请注册商标 8 项，获得注册商标 4 项。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 130 项、软件著作权 15 项、集成电路布图设计权 82 项、注册商标 16 项。公司专利涉及 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等存储芯片的设计核心环节，技术护城河不断加深。

### 2026 年行动举措：

2026 年，公司将继续深耕存储主业，推进产品制程迭代，通过工艺优化与规模效应降低单位成本；持续提升产品可靠性指标，强化车规级认证布局，切入汽车电子等高附加值市场，提升产品毛利水平。同时，公司将持续深化“存、算、联”一体化战略，力争在 Wi-Fi 7 芯片及砺算 GPU 芯片的市场化落地方面取得突破。公司将积极推动与供应链上下游伙伴的紧密合作，推动产业链的共同创新与发展，并视情况开展符合未来发展战略的投资、并购或其他战略合作。

## 二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，建立了包括股东会、董事会和管理层组成的较为完善的公司治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间的权责明确、运作规范的公司治理体系。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》

《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《东芯半导体股份有限公司章程》《信息披露管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等32部公司治理制度进行了制定、修订。上述制度的制定与修订，进一步夯实了公司规范运作的制度根基。通过将监管新规与公司实际情况深度融合，公司有效提升了治理体系的科学性与有效性，强化了风险防范与应对能力。

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数人员”的培训工作，组织相关人员积极参加各类合规培训。报告期内，公司积极组织董事、高级管理人员及相关工作人员参加证监会、上海市证监局、上交所、中国上市公司协会、上海上市公司协会等举办的各类培训，加强证券市场相关法律法规的学习，不断强化合规意识，提升公司董高履职能力，推动公司持续规范运作。

#### **2026年行动举措：**

2026年，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，定期自查，及时修订公司管理制度，调整及完善公司治理架构及运作机制。公司将继续加强董事、高级管理人员的培训工作，组织相关人员积极参加各类监管机构举办的各类培训，不断提升其合规意识与履职能力。公司将强化董事会专门委员会的职能发挥，提升董事会决策的科学性和有效性。

### **三、加强投资者沟通，提升信息披露质量**

公司坚持以投资者需求为导向，持续完善多渠道、多层次的投资者沟通体系。在信息披露文件中突出价值信息的针对性与重要性，在定期报告中强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，为投资者的价值判断与决策提供充分依据；同时依法依规、适时开展自愿性信息披露，积极传递公司内在价值与投资潜力。

公司充分尊重并维护股东合法权益，认真听取投资者对公司战略发展、经营管理等方面的意见建议。报告期内，公司常态化、高效地组织定期报告业绩说明会，董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监等核心管理层出席，与投资者积极互动交流；组织并参加路演、反路演、策略会等投资者调研活动累计超百场；通过股东会、上证e互动、官网投资者关系专栏、投资者热线及邮箱等多元化渠道开展沟通交流，切实保障投资者的知情权与参与权。

公司不断探索创新信息披露形式，积极采用图文、视频、语音等多元化载体，提升信息披露的可读性与实用性。公司通过微信公众号“东芯半导体”推出“一图读懂”系列图文解读，报告期内累计发布推文 50 余篇，粉丝总数超 17,000 人。报告期内，公司积极参与上海证券交易所、上证路演中心举办的“科创 3 分钟·高管开放麦”活动，由公司董事长以短视频形式生动解读“存、算、联”一体化战略布局，帮助投资者更直观、透彻地理解公司中长期发展战略与业务逻辑。

此外，公司积极践行可持续发展理念，重视 ESG 对企业发展的作用，将其融入商业模式与管理体系。公司披露了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面展现了公司在环境保护、社会责任及公司治理领域的实践与绩效（详见公司 2026 年 4 月 23 日披露的相关报告）。

凭借扎实、透明的投资者关系管理工作，公司在报告期内获得资本市场广泛认可，荣获财联社“2025 最佳投资者关系团队”、价值在线“2025 年度上市公司卓越投关建设奖”、同花顺“2025 最具人气上市公司 TOP300”等多项荣誉，进一步提升了公司在投资者关系领域的品牌形象与影响力。

#### **2026 年行动举措：**

公司将继续严格遵循法律法规与监管要求，贯彻执行信息披露管理制度，持续提升信息披露质量。公司将召开不少于三次（含）业绩说明会，并不断创新沟通形式，持续优化可视化报告、图文及短视频解读等创新方式，降低阅读门槛，引导投资者更好理解公司投资价值；同时，建立更为完善的投资者意见征询与反馈机制，认真听取意见建议，助力公司高质量发展。此外，公司将继续做好环境、社会和公司治理（ESG）报告的披露工作，持续提升可持续发展信息披露质量。

#### **四、完善投资者回报机制，提升投资者信心**

公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，在注重生产经营的同时，重视广大投资者的回报，通过多种方式维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。

公司积极引导控股股东增持公司股份，维护市场稳定。基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，公司控股股东东方恒信集团有限公司于 2024 年 10 月推出增持计划。截至 2025 年 1 月 27 日，控股股东已完成本次增持计划，累计增持公司股份 8,411,537 股，占公司总股本 1.9020%，增持

金额合计人民币 219,923,992.47 元（不含交易费用）。

鉴于芯片行业需持续投入大额研发开支，且公司近年来围绕“存、算、联”一体化战略的前瞻性技术布局尚处于投入期，较高水平的研发投入及对外投资使得公司短期利润承压，截至报告期末母公司未分配利润为负，暂不具备现金分红的基础条件。为建立健全长效的股东回报机制，畅通分红渠道，公司董事会已审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并拟提交股东会审议。本次以公积金弥补亏损后，公司将消除未分配利润为负的状况，从而具备未来的分红基础条件，为与股东共享发展成果创造必要前提。

### **2026 年行动举措：**

2026 年，公司将继续致力于提升盈利能力，改善经营业绩，努力平衡公司发展、业绩增长与股东回报三者之间的关系。公司将始终秉持投资者为本的原则，确保在公司长期稳定健康发展的基础上，重视对投资者的合理回报，与股东共享公司发展的成果。公司将统筹考虑现金分红、送转股份、股份回购等方式，探索科学、合理的投资者回报机制，增强投资者的价值获得感。同时，公司将密切关注市场对公司价值的评价，制定并完善稳定股价预案，在出现股价短期连续或大幅下跌等情形时，适时采取合规措施维护市值稳定。

## **五、重视人才培养，健全长效激励机制**

公司始终坚持“以人为本”的发展理念，秉持“人才优先，服务发展，使用为本”的原则，视人才为企业发展的核心驱动力。公司注重员工能力培养与职业发展，制定并实施系列培训管理规范与内训师管理制度，构建起涵盖人才培养开发、评价选拔、流动配置、激励保障的特色培训管理体系，形成覆盖全员、贯通全周期的入职培训与在岗培训体系，推动各类培训项目有机衔接、协同落地。

公司常态化开展培训需求调研，广泛征集并梳理员工培训诉求，科学制定年度培训计划。在分层级培养方面，公司全力打造多元化、高质量的人才队伍：针对新员工，开展入职引导及项目实战演练，帮助新员工快速融入公司文化与工作节奏；对于技术人员，以市场需求与行业技术发展为导向，为核心技术储备人才制定专项培养计划，通过长期技术培训、专题讲座及团队技术专家“以老带新”等方式，提升员工专业素养、增强归属感与责任意识；针对管理梯队，打造领导力发展项目，形成分类分层、精准施训的培养格局。

同时，公司充分发挥内部讲师在知识传承中的核心作用，严格选拔兼具专业素养与表达能力的员工作为内训师，通过分级认定与授课激励机制，持续激发讲师队伍活力。针对关键岗位及特殊工种，公司定期开展专业技能、质量意识、职业安全等专项培训，并结合训后考核与效果评估，持续优化课程内容与授课质量，为员工能力提升与长远发展提供有效支撑。

在激励机制方面，公司不断完善激励约束机制，优化薪酬体系与绩效考核制度，建立健全公司长效激励机制，充分调动公司各管理层和核心业务（技术）骨干的积极性，增强公司凝聚力。为了进一步吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，公司已连续多年推行股权激励计划。报告期内，公司顺利实施了 2025 年度股权激励方案，并完成了 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关归属期的股份归属工作。

公司为股权激励计划设置了科学严谨的考核体系，选取了营业收入增长率作为公司层面的业绩考核要求，并对所有激励对象设置了个人层面的绩效考核要求，根据激励对象的年度考核结果确定其是否符合归属条件。以上考核体系有效实现了股权激励的约束作用，提升了激励对象的积极性，有助于提升公司活力及发展动力，促进公司健康长远可持续发展，增强投资者回报。

#### **2026 年行动举措：**

2026 年，公司将继续加大人才培养力度，进一步完善人才梯队建设，持续优化分层分类的培训体系与内部讲师赋能机制，通过内部培养与外部引进相结合，不断提升员工的专业技能和综合素质。公司将建立更加完善的员工激励机制，继续推行常态化股权激励计划，严格落实股权激励计划的考核指标要求，确保管理层与核心员工与公司目标一致，实现风险收益共担，共同促进公司可持续健康发展。

## **六、其他事宜**

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。未来，公司将继续积极推动并落实 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，持续评估行动方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。未来，公司将持续深耕主业，强化核心竞争力、提升盈利能力、提高公司治理水平，履行上市公司责任，塑造良好的市场形象，切实维护投资者利益，增强投资者信心，为股东创

造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年4月23日